



クリアフィル®
ユニバーサルボンド Quick 2

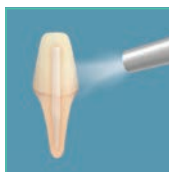


SA ルーティング®
Multi

通法にしたがい、根管形成及び、根管充填を行った後、
築造窩洞の形成、コアの試適等を行ってください。

1 レジンコアの表面処理

サンドブラスト処理※1
超音波洗浄・乾燥



より高い接着力を求める場合

①「クリアフィル®ユニバーサルボンド
Quick 2」塗布

待ち時間なしで ②へ



② 乾燥

マイルドなエアブローで5秒以上乾燥※2

5秒以上乾燥



2 コアの被着面または築造窩洞内へペーストを注入



築造窩洞内へ注入した
場合は40秒以内に ③へ

「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick 2」を塗布した
場合は30秒以内に ③へ

3 コアの装着※3、余剰セメント除去※4



1か所につき2～5秒光照射

「クリアフィル®ユニバーサルボンド Quick 2」を塗布した
場合は1ヶ所につき1～2秒光照射

4 マージン部に光照射



照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	10秒

光量についてはP.1を参照ください。

5 支台歯形成

10分保持し形成



POINT

- ※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の電子添文等にしてください。
- ※2 バキュームで吸引しながら液面が動かないまで乾燥してください。根管内に残った余剰のボンドはペーパーポイント等で除去し、その後再度エアブローで乾燥してください。
- ※3 気泡の混入にご注意ください。
- ※4 化学硬化により除去する際は2～4分保持してください。